

製造業のビジネスチャンスが見える
モノづくり最新情報サイト
じゃぱんお宝にゆ〜す
<https://japan.otakaraneews.com>

じゃぱんお宝にゆ〜す

モノづくり現場の未来を見つめる
製造業応援サイト
じゃぱんお宝WEB新聞
最新情報満載！好評配信中！



最新300mm Fab Outlook to 2026レポート情報

300mm半導体前工程ファブ生産能力、2026年ピークへ 地域別では、2026年に中国が生産能力でリード予測 製品別では、アナログとパワーが30%増で他分野リード

最新300mm生産能力 月産960万枚を予測

SEMI(米国カリフォルニア州)は3月27日、最新の300mm Fab Outlook to 2026レポートにおいて、世界の300mm半導体前工程ファブの生産能力が2026年に過去最高の月産960万枚まで増加する予測を発表した。

300mmファブの生産能力は2021年～2022年に旺盛な成長をした後、2023年はメモリおよびロジックデバイスの需要軟化により成長が減速することが予測される。

2026年に生産能力 過去最高を予測

SEMIプレジデント兼CEOのAjit Ma

nocha(アジット・マノチャ)氏によれば、「世界の300mmファブ生産能力の拡大ペースは緩やかになっているが、業界は堅調な半導体需要に対応するための生産能力増強に引き続き注力している。ファウンドリ(マイクロ、ロジックを含む)、メモリ、パワーの3部門が2026年に予想される生産能力の新記録到達へ大きな原動力となるだろう」と予測する。

82の新規稼働計画

2022年～2026年の予測期間中に需要増に対応して300mmファブ生産能力を増強することが予想される企業にはGlobalFoundries、Hua Hong Semiconductor、Infineon、Intel、KIOXIA、Micron、Samsung、SK Hynix、SMIC、

STMicroelectronics、Texas Instruments、TSMC、UMCがある。各社の合計では、2023年～2026年に82の新規ファブ/ラインの稼働が計画されている。

地域別見通し 中国がリード

地域別見通しでは、米国の輸出規制を受ける中国は成熟技術に政府投資を集中して300mmファブの生産能力をリードし、世界シェアを2022年の22%から2026年には25%に引き上げ、月産240万枚に達することが見込まれている。

韓国の300mmファブ生産能力の世界シェアはメモリ市場の需要低迷により、2022年～2026年にかけて25%から23%に低下する見込み。台湾は同期間に22%から21%に低下するものの、3位を

維持すると予測。

また日本のシェアは他の地域との競争が激化する中で、2022年の13%から2026年には12%に低下すると予測されている。

自動車分野の旺盛な需要と政府投資を受け、米州と欧州・中東の両地域は2022年～2026年にかけて300mmファブ生産能力のシェアを拡大することが予想される。

米州の世界シェアは2026年までに0.2%から9%近くにまで上昇し、また欧州・中東のシェアは6%から7%に上昇する見込みで、東南アジアの同期間のシェアは4%を維持すると思われる。

製品別見通しでは アナログとパワー

一方、製品分野別の見通しでは、SEMI 300mm Fab Outlook to 2026レポートによると、2022年～2026年までの年平均成長率はアナログとパワーが30%で他の分野をリードし、ファウンドリが12%、オプトが6%、メモリが4%で続く。

2023年3月14日に発行されたSEMI 300mm Fab Outlook To 2026レポートは、366のファブ/ライン(稼働中258、計画中108)を収録している。

いずれにしても半導体は恒久的な成長産業として期待されている。

統計に関する 問合せ先

- ◇SEMIジャパン マーケティング部
- ◇Email : jmarketing@semi.org
- ◇Tel : 03-3222-5854

(※資料提供：SEMIジャパン)

